

0422强势股脱水 | 这个资产越用越值钱了

2026/04/22 17:40

“

- ①半导体：国内AI芯片对先进封装需求快速释放，盛合晶微以85%的大陆2.5D市占率站上核心卡位，募投扩产落地后有望持续受益于国产高算力芯片产业链的价值量重构与规模爆发。
- ②电子元件：深圳华强年营收创历史新高，扣非净利润同比增长164%，在分销本土化持续深化的基础上，昇腾生态从代理走向自研边缘AI计算系统，正从“卖元器件”向“卖算力解决方案”升维转型，打开更高价值天花板。
- ③算力租赁：Agent应用爆发带动Token消耗量级增长，H100年租价格四个月内涨幅近40%，国内云厂商集体提价印证供需拐点，现有电力和GPU存量资产的稀缺价值正加速被重定价。

本文是对当日大涨公司进行研报深度复盘，相关个股信息仅供参考，不构成投资建议。

1、先进封装：又一个千亿龙头

(1) 大涨题材：半导体

此前一直被寄予厚望的国内先进封装龙头盛合晶微近日完成科创板上市。

公司提供晶圆级封装（WLP）和芯粒多芯片集成封装等先进封测服务，已构建以2.5D/3D先进封装为核心的技术平台。此外，尽管业务规模小于长电科技、通富微电等可比公司，但公司2024年毛利率达23.53%，显著高于行业平均的14.33%，净利率4.54%也高于行业均值的3.36%。

后摩尔时代先进封装成为提升芯片性能的重要途径，先进封装有助于提高集成度，提升数据传输速度与带宽，实现异构集成并加快产品上市时间，高度契合AI发展特点。

行情上，公司今日上市第二日涨近24%。



(2) 研报解读（中泰证券、爱建证券、天风证券、华泰证券）：先进封装时代的大陆主角

①随着制程节点推进，芯片面积受限于单次光罩尺寸（33mm×26mm），量子隧穿效应影响晶体管稳定性，制造成本快速攀升——5nm制程晶圆厂5万片/月产能投资高达160亿美元，是28nm制程的2.7倍。在此背景下，2.5D/3D封装成为突破单芯片面积限制、实现高算力芯片性能跃升的核心技术路径，被业界认为是微电子行业继平面工艺、铜互联、FinFET之后的第四波重大技术浪潮。

②先进封装市场高速扩张，2.5D/3D封装是增速最快细分。全球2.5D/3D封装市场规模从2019年的24.9亿美元增至2024年的81.8亿美元，复合增长率26.9%，预计2029年达到258.2亿美元，2024-2029年复合增长率25.8%。中国大陆由于外部供应受限，更需依赖本土先进封装实现高算力芯片自主可控，大陆2.5D/3D封装市场增速将显著高于全球均值。

③公司多项业务大陆市占率排名第一，2.5D封装市占率高达85%。截至2024年，公司Bumping（市占率25%）、12英寸WLCSP（市占率31%）及2.5D（市占率85%）收入规模在中国大陆均排名第一。公司是大陆量产2.5D封装最早的企业之一，代表大陆该领域最先进水平，与台积电、三星等全球龙头不存在技术代差——最小微凸块间距达20μm，最大硅转接板尺寸约合3倍光罩，与台积电（约合3.3倍光罩）接近。

④公司全球市占率从2022年的0.6%、2023年的1.1%提升至2024年的1.6%，成功跻身全球前十大封测企业。此外，在地缘政治背景下，大陆封测厂在AI产业链中的地位显著高于海外封测厂——以CoWoS为例，海外封测厂仅承接部分外溢订单，而大陆封测厂主导除interposer外的其他全流程，价值量更高。

公司本次IPO募资50.28亿元，其中48亿元用于2.5D/3D先进封装扩产：三维多芯片集成封装项目总投资84亿元（拟募集40亿元），建成后新增2.5D/3DPackage产能1.6万片/月及Bumping产能8万片/月；超高密度互联三维多芯片集成封装项目总投资30亿元（拟募集8亿元），建成后新增3DIC产能4000片/月。

2、深圳华强：你这芯片怎么卖？

(1) 大涨题材：电子元件

公司年报实现营收249.09亿，同比增长13.46%，创历史新高，扣非归母净利润4.25亿，同增164.22%。

公司为国内最早开展本土产品线授权分销业务的公司之一，与国内头部半导体原厂的合作关系稳固。此外，公司还是华为海思全系列授权分销商，获得昇腾APN金牌部件伙伴认证，自主开发基于FPGA+昇腾NPU双芯驱动的NeuSemi-Ascend边缘AI计算系统。

行情上，在近期DeepSeekV4预期下，以华为昇腾为代表的国产算力系统备受关注，公司今日涨停。



2) 研报解读（东北证券）：多轮驱动

①公司代理全球MLCC及大功率器件龙头产品线，面向服务器ODM、数据中心电源、光模块等AI算力基建相关领域的销售规模稳步提升；作为江波龙、兆易创新等存储厂商的重要代理商，亦受益于AI对算力及存力需求的持续拉动，存储类产品线授权分销收入同比大幅增长。

②公司是华为海思全系列授权分销商，深度参与海思产品的应用方案研发与推广。在此基础上，公司进一步自主研发了基于FPGA+昇腾NPU双芯驱动的NeuSemi-Ascend边缘AI计算系统，覆盖高端工业检测、轨道交通监控、电力巡检、应急快反边防等信创场景，于2026年3月华为中国合作伙伴大会亮相智慧大企业展区。

③2024年和2025年，公司本土产品线出货金额占授权分销业务出货总额比例均超过60%，以海思、纳芯微为代表的部分产品线连续两年保持快速增长。采购端，公司代理的美国产品线数量占比极低，全部SKU近2万个中仅不到100个SKU原产于美国，对应采购金额比例仅约0.2%；销售端，出口占比约为2%且基本没有出口至美国的业务，本次美国加征关税对公司直接影响极小。

④华强北业态升级引领流量，华强电子世界时尚电子业态出租率接近100%，单日客流峰值突破10万人次；华强电子网累计注册用户超175万；同时公司围绕具身智能积极储备增量，投资机器人关节模组企业脉塔智能，并拓展地瓜机器人等智能计算芯片产品线代理权。

3、云计算数据中心：更值钱了

(1) 大涨题材：算力租赁

根据Semianalysis，H100一年期GPU租赁合同价格从2025年10月的每小时1.70美元涨至2026年3月的每GPU每小时2.35美元，涨幅近40%。B300算力卡云租赁价格从2025年12月

5.68美元上涨至2026年4月13日的9.87美元/小时，涨幅高达74%。

国海证券认为，推理在新算力系统上运行效果最佳，但训练工作负载在H100系列显卡上则能获得最佳性价比，因此即使是较老的显卡也需求旺盛。

行情上，协创数据、宏景科技等连创新高。



远东股份 600869.SS	17.18	+9.99%	14:56:07	9.41%	381.28亿
-------------------	-------	--------	----------	-------	---------

协创数据 300857.SZ	260.76	+19.99%	--	8.63%	1257.04亿
-------------------	--------	---------	----	-------	----------

宏景科技 301396.SZ	324.28	+16.09%	--	23.60%	246.72亿
-------------------	--------	---------	----	--------	---------

博睿数据 688229.SS	96.19	+11.40%	--	9.38%	42.71亿
-------------------	-------	---------	----	-------	--------

工业富联 601138.SS	66.89	+8.92%	--	1.59%	13273.71亿
-------------------	-------	--------	----	-------	-----------

紫光股份 000938.SZ	29.92	+8.37%	--	11.30%	855.73亿
-------------------	-------	--------	----	--------	---------

(2) 研报解读（国海证券、国盛证券）：AI核心资产

①目前按需GPU租赁容量在所有GPU类型中均已售罄。国内主要云服务商也集体上调价格：腾讯云混元系列模型涨幅超400%，阿里云算力卡产品上涨5%~34%，百度云AI算力相关产品上涨约5%~30%，"此轮调价非单一厂商行为，是行业供需格局变化的明确信号，量价上行具备较强持续性。"

②推理需求拐点到来，Token消耗量级增长。OpenClaw（"养虾热"）等Agent工具单次互动Token消耗量可达传统AI的10至100倍；受益于Claude Code等编程Agent商业化能力突出，Anthropic年度经常性收入（ARR）从2025年底的90亿美元，在不到四个月内增至2026年4月的300亿美元。

③应用场景多元化拉长GPU有效生命周期，残值有望重估。国海证券指出，**MoE等推理工作负载在最新大型系统（如GB300）上运行效果最佳，此外，算力设备折旧期满残值有望获得重估**，叠加DRAM和NAND内存价格上涨导致服务器采购成本压缩项目预期回报，部分新供给被迫滞后，进一步收紧租赁市场。

④国内代表企业加大融资与采购力度，扩张节奏加快。协创数据2026年已累计申请授信额度不超过500亿元，并推进赴港上市备案；宏景科技2026年拟申请综合授信额度600亿元，同时拟定增12.90亿元用于智能算力集群建设；盛视科技2026年已累计申请授信额度不超过230亿元。国盛证券指出，当前AIDC并网电量短期难以迅速提升，存量电力有望持续受益，"龙头效应显现"。

研报来源：

中泰证券，王芳，S0740521120002，本土先进封装龙头，充分受益AI大趋势，2026年4月12日。

爱建证券，王凯，S0820524120002，盛合晶微上市，看好先进封装设备机遇，2026年4月21日。

天风证券，李双亮，S1110525120002，盛合晶微新股报告：先进封装龙头扬帆起航，2026年4月19日。

华泰证券，黄乐平，S0570521050001，SEMICON China 2026：先进封装与光互连引领AI半导体新周期，2026年3月31日。

东北证券，李玖，S0550522030001，营收创历史新高，昇腾全栈生态加速变现，2026年4月5日。

国海证券，刘熹，S0350523040001，算力租赁：锐度鲜明的中国AI核心资产，2026年4月21日。

国盛证券，宋嘉吉，S0680519010002，Agent爆发，Neocloud、AIDC、算力租赁受益，2026年4月21日。

*免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议

*风险提示：股市有风险，入市需谨慎

本资讯中的内容来自持牌证券机构，意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖做出保证。投资者不应将本资讯作为投资决策的唯一参考因素。亦不应以本资讯取代自己的判断。

本文内容和观点不代表选股通APP平台观点，请独立判断和决策。在任何情况下，选股通APP不对任何人因使用本平台中的内容所引致的任何损失负任何责任。